

电路板术语总整理

~A~

A-stage MBA A 阶段
Abietic Acid 松脂酸
Abrasion Resistance 耐磨性
ABS 树脂
Absorption 吸入 吸收
Accelerated Test (Aging)加速试验, 加速老化
Acceleration 速化反应
Accelerator 加速剂, 速化剂
Acceptability, Acceptance 允收性, 允收
Acceptance Quality Level (AQL) 可接受质量水平
Acceptance Tests 验收试验
Access Hole 露出孔 (穿露孔, 露底孔)
Accuracy 准确度
Acid Number (Acid value)酸值
Acrylic 压克力
Actinic Light (or Intensity, or Radiation)有效光
Activation 活化
Activator 活化剂
Active Parts (Devices) 有源器件
Acutance 解象锐利度
Add-on Component 附加元件
Addition Agent 添加剂
Adhesion 附着力
Adhesion Promoter 附着力促进剂
Adhesive 胶类或接着剂
Admittance 导纳
Aging 老化
Air Inclusion 气泡夹杂
Air Knife 风刀
Algorithm 演算法
Aliphatic Solvent 脂肪族溶剂
Ambient Temp.环境温度
Amp-Hour 安培小时
Anchoring Spurs 着力爪
Angle of Attack 攻角
Angle of Contact 接触角
Anion 阳向游子 (阴离子)

Anneal 韧化
Annular Ring 孔环
Anode 阳极
Anode sludge 阳极泥
Anodizing 阳极化
ANSI (American National Standard Institute) 美国标准协会
Anti-Pit Agent 抗凹剂
AOI(Automatic Optical Inspection)自动光学检测
AQL (Acceptable Quality Level)品质允收水准
Resistance 耐电弧性
Array 排列, 阵列
Artwork 底板
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)特定用途的单体电路板
Aspect Ratio 纵横比
Assembly 装配, 组装, 构装
Assembly Density 组装密度
ATE (Automatic Testing Equipment)自动电测设备
Autoclave 压力锅
Axial-lead 轴心引脚
Azeotrope 共沸混合液

~B~

B-Stage`B 阶段
Back Light (Back Liking)背光法
Back Taper 反锥斜法
Back-up 垫板
Backpanels, Backplanes 支撑板
Ball Grid Array (BGA) 球栅阵列
Bandability 弯曲性, 弯曲能力
Banking Agent 护岸剂
Bare Chip Assembly 裸体晶片组装
Barrel 孔壁, 滚镀
Base Material 基材
Basic Grid 基本方格
Batch 批
Baume 波美度
Beam Lead 光芒式的平行密集引脚
Bed-of-Nail Testing 针床测试
Bellows Contact 弹片式接触

Beta Ray Backscatter 贝它射线反弹散	Bus Bar 汇电焊
Beveling 切斜边、倒斜边	Butter Coat 外表树脂层
Bias 斜张网布, 斜织法	~C~
Binder 粘结剂	
Bits 头	Cable 电缆
Black oxide 黑氧化层	CAD (computer Aided Design) 电脑辅助设计
Blanking 冲空断开	Calendered Fabric 轧平式网布
Bleach 漂洗	Cap Lamination 帽式压合法
Bleeding 溢流, 渗出	Capacitance 电容
Blind via Hole 盲导孔	Capacity Coupling 电容
Blister 局部性分层	Capillary Action 毛细作用
Block Diagram 电路系统块图	Carbide 碳化物
Blockout 封网	Carbon Treatment, Active 活性炭处理
Blotting 干印	Card 卡板
Blotting Paper 吸水纸	Card Cages/Card Racks 电路板构装箱
Blue plaque 蓝纹	Carlson Pin 卡式定位梢
Blow Hole 吹孔	Carrier 载体
Bomb sight 弹标	Cartridge 滤芯
Bond 焊(连)接	Castallation 保型积体电路器
Bond strength 结合强度	Catalyzed Board , catalyzed substrate (or Material)催化板材
Bondability 结合性	Catalyzing 催化
Bonding Layer/Sheet 结合层, 粘结层	Cathode 阴极
Bonding sheet (layer) 结合片, 结合层	Caul Plate 隔板
Bonding wire 结合线	Cavitation 空泡化, 半真空
Bow, Bowing 板弯	Center-to-center spacing 中心间距
Braid 编线	Ceramics 陶瓷
Brazing 硬焊	Cermet 陶金粉
Break-away panel 可断开板	Certificate 证明书
Break point 出像点, 显像点	CFC 氟氯碳化物
Breakdown voltage 崩溃电压	Chamfer 倒角
Break-out 破出	Characteristic Impedance 特性阻抗
Bridging 搭桥, 桥接	Chase 绸框
Bright-Dip 光泽浸渍处理	Check List 检查清单
Brightener 光泽剂	Chelate 螯合
Brush plating 刷镀	Chemical Milling 化学研磨
Build-up 增厚, 堆积	Chemical resistance 耐化学性
Bulge 鼓起, 凹出	Chemisorption 抗化性
Bulge Hole 冷冲	Chip/die/dice 裸芯片
Bump 突块	Chip Carrier 芯片载体
Buoyancy 浮力	Chip on Board 晶片粘着板
Buried via Hole 埋导孔	Chip Scale Package)CSP)/Chip Scale Mounting 芯片级组装
Burn-in 高温加速老化试验	
Burning 烧焦	
Burr 毛头	

Chisel ...刃	Corner Crack 通孔断角
Circumferential Separation 环状断孔	Corner Mark 板角标记
Clad/Cladding 披覆	Counterboring 方形扩孔, 埋头孔
Clean Room 无尘室, 洁净室	Countersinking 锥形扩孔
Cleanliness 清洁度	Coupon, Test coupon 板边试样
Clearance 余地, 余隙, 余环	Cover lay /Cover coat 表护层, 保护层
Clinched Lead Terinal 紧钳式引脚	Crack 裂痕
Clinched-wire Through Connection 通孔弯线连接法	Crazing 白斑
Clip Terminal 绕线端接	Crease 皱褶
Co-Firing 共烧	Creep 潜变
Coat, Coating 皮膜, 表层	Crosssection Area 载面积
Coaxial Cable 同轴缆线	Crosshatching 十字交叉区
Coefficient of Thermal Expansion 热膨胀系数	Crosslinking, Crosslinkage 交连, 架桥
Cold Flow 冷流	Crosstalk 杂讯, 串讯
Cold Solder Joint 冷焊点	Cure 硬化, 热化
Collimated Light 平行光	Current Density 电流密度
Colloid 胶体	Curtain Coating 濂涂法
Columnar structure 柱状组织	Current-carrying capability 载流能力
Complex ion 错离子	~D~
Component Hole 零件孔	D-glass D 玻璃
Component Orientation 零件方向	Datum Reference 基准参考
Component Side 组装机	Daughter Board 子板
Composites (CEM-1,CEM-3) 复合板材	Deburring 去毛头
Conditioning 整孔	Declination Angle 斜射角
Conductance 导电	Definition 边缘逼真度
Conductive salt 导电盐	Degradation 劣化
Conductivity 导电度	Degreasing 脱脂
Conductor spacing 导电间距	Deionized Wate 去离子水
Conformal Coating 贴护层, 护形	Delamination 分层
Conformity 吻合性, 服帖性	Dendritic Growth 柱状生长
Connector 连接器	Densitomer 透光度计
Contact Angle 接触角	Dent 凹陷
Contact Area 接触面	Deposition 皮膜处理
Contact Resistance 接触电阻	Desiccator 干燥器
Continuity 连通性	Desmearing 除胶渣
Contract Service 协力厂, 分包商	Desoldering 解焊
Conversion Coating 转化皮膜	Developer 显像液 显像机
Coplanarity 共面性	Developing 显像
Copolymer 共聚物	Deviation 偏差
Copper Foil 铜箔, 铜皮	Device 电子元件
Copper Mirror Test 铜镜	Dewetting 缩锡, 半润湿
Copper Paste 铜膏	Diazo Film 偶氮棕片
	Dichromate 重铬酸盐

Dicyandiamide (Dicy)双氰胺
Die 冲膜 铸膜
Die Bonding 晶粒接着
Die stamping 冲压
Dielectric 介质
Dielectric Breakdown Voltage 介质崩溃电压
Dielectric Constant 介质常数
Dielectric strength 介质强度
Differential Scanning Calorimetry (DSC) 微差扫描热卡分析法
Diffusion Layer 扩散层
Digitizing 数位化
Dihedral Angle 双反斜角
Dimensional stability 尺度安定性
Diode 二极管
DIP(Dual Inline Package) 双排角封装体
Dip Coating 浸涂法
Dip Soldering 浸焊法
Dipole 偶极, 双极
Direct Emulsion 直接乳胶
Direct/Indirect Stencil 直间版膜
Direct Plating 直接电镀 直接镀板
Discrete Component 散装零件
Dish Down 碟形下陷
Dispersant 分散剂
Dissipation Factor 散逸因子
Double Layer 电双层
Double Treated Foil 双面处理铜箔
Drag in/Drag out 带进/带出
Drag Soldering 拖焊
Drilled Blank 已钻孔的裸板
Drill Facet 钻尖切削面
Drilling 钻孔
Dross 浮渣, 焊渣
Drum side 铜箔光面
Dry film 干膜
Dual Wave soldering 双波焊接
Ductility 展性
Durometer 橡胶硬度计
~E~

※E-glass 电子级玻璃

Eddy Current 涡电流
Edge-Board Connector 板边(金手指)承接器
Edge-Board contact 板边金手指
Edge-Dip Solderability Test 板边焊锡性测试
Edge Spacing 板边空地
EDTA 乙二胺四醋酸
Effluent 排放物
Elastomer 弹性体
Electric strength (耐) 电性强度
Electrical Bridging 电桥接
Electrodeposition 电镀
Electro-Deposited Photoresist 电阻光阻
Electro-migration 电迁移
Electro-phores 镀锡
Electro-winning 电解冶炼
Electroless-deposition 无电镀
Electrolytic Cleaning 电解清洗
Electrolytic Tough Pitch 电解铜
Elongation 延伸性, 延伸率
Embedded Component 嵌入元件
Embossing 凸出性压花
EMF 电动势
EMI 电磁干扰
Emulsion 乳化
Encapsulating 囊封, 胶囊
End Cap 封头
Entrapment 杂物
Entry Material 盖板
Epoxy Resin 环氧树脂
Etchant 蚀刻剂, 蚀刻液
Etchback 回蚀
Etch Factor 蚀刻因子, 蚀刻函数
Etching Indicator 蚀刻指标
Etching Resist 抗蚀阻剂
Eutectic Composition 共融组成
Exposure 曝光
Extraneous plate 渗透
Eyelet 铆眼
~F~

Fabric 网布

Face Bonding 反面朝下之结合
Failure 故障, 损坏
Farad 法拉
Faradu 法拉第
Fatigue Strength 抗疲劳强度
Fault 缺陷, 瑕疵
Fault plane 断层面
Feed Rate 进给速率
Feed Through Hole 导通孔
Feeder 进料器, 送料器
Fiber Exposure 玻织显露
Fiducial Mark 基准记号
Filament 织丝
Fill 纬向
Filler 填充料
Fillet 内圆填角
Film 底片
Filter 过滤器, 滤光镜片
Fine Line 细线
Fine Pitch Devices(FPD) 精细间距器
件
Fineness 纯度, 成度, 粒度
Finger 手指(板边连续排列接点)
Finishing 终饰, 终修
First Article 首产品
First Pass—Yield 初试良品率,
Fixture 夹具
Flair 第一面外缘变形, 刃角变形
Flame Resistant 耐燃性
Flammability Rate 可燃速度
Flare 扇形崩口
Flash plating 闪键
Flashover 闪络
Flat cable 扁平排线
Flat pack 扁平封装
Flexible printed circuit, FPC 软板
Flexural Failure 翘曲损坏
Flexural strength 抗翘强度
Flip Chip Package 倒装芯片封装
Flocculation 絮凝, 凝聚
Flood stroke Print 覆墨冲程印刷
Flow soldering 流焊
Fluorescence 路萤光
Fluorocarbon Resin 碳氟树脂

Flush Conductor 嵌入式线
Flute 退屑槽
Flux 助焊剂
Foil Burr 铜箔毛边
Foil Lamination 铜箔压板法
Foot 残足
Foot Print (Land Pattern)脚垫
Foreign Material 异物, 外来物
Form-to-List 布线说明清单
Free Radical 自由基
Frequency 频率
Fully-Additive Process 全加成法
Fungus Resistance 抗霉性
Fused Coating 熔锡层
Fusing 熔合
~G~
Gage, Gauge 量规
Galvanic Series 贾凡尼次序
Galvanizing 镀锌
GAP 第一面分离, 长刃断开
Gel Time 胶化时间
Gelation Particle 胶凝点
Gerber Date, Gerber File 格博
Ghost Image 阴影
Gilding 镀金
Glass Fiber 玻织
Glass Fiber protrusion/Gouging ,Groove
玻织突出
Glass Transition Temperature, Tg 玻璃
态转化温度
Global Test 球状测试纸
※Golden Board 测试用标准板
※Grain size 结晶粒度
Grid 标准格
Ground Plane (or Earth Plane)接地层
Ground Plane Clearance 接地空环
Gull Wing Lead 欧翼引脚
Grass Leak 大漏
Guide Pin 导针
~H~
Half Angle 半角
Halide 卤化物

Haloing 白圈, 白边
 Halon 海龙
 Hard Anodizing 硬阳极化
 Hard Chrome plating 镀硬铬
 Hard soldering 硬焊
 Hardener (Curing Agent) 硬化剂
 Hardness 硬度
 Haring-Blum Cell 海因槽
 Harness 电缆组合
 Hay Wire 跳线
 Heat Cleaning 烧洁
 Heat sink plane 散热层
 Heatsink Tool 散热工具
 Hertz(HZ)赫
 Hi-Rel 高可靠度
 Hipot Test 高压电测
 Hit 擎
 Hole breakout 孔位破出
 Hole Counter 数孔机
 Hole Density 孔数密度
 Hole preparation 通孔准备
 Hole pull Strength 孔壁强度
 Hole void 破洞
 Hook 切削刃缘外凸
 Hot Air leveling 喷锡
 Hot Bar (Reflow)Soldering 热把焊接
 Hot gas Soldering 热风手焊
 HTE(High Temperature Elongation) 高温延伸性
 Hull Cell 哈氏槽
 Hybrid Integrated Circuit 混成电路
 Hydraulic Bulge Test 液压鼓起试验
 Hydrogen Embrittlement 氢脆
 Hydrogen Overvoltage 氢超电压, 氢过电压
 Hydrolysis 水解
 Hydrophilic 亲水性
 Hygroscopic 吸湿性
 Hypersorption 超吸附
 ~I~
 I.C. Socket 积体电路器插座
 Icicle 锡尖
 Illuminance 照度
 Image Transfer 影象转移, 图象转移
 Immersion Plating 浸镀
 Impedance 阻抗, 特性阻抗
 Impedance Match 阻抗匹配
 In-Circuit Testing 组装板电测
 Inclusion 异物, 夹杂物
 Indexing Hole 基准孔, 参考孔
 Inductance(L)电感
 Infrared (IR)红外线
 input/output 输入, 输出
 Insert, Insertion 插接, 插装
 Inspection 检验
 Inspection Overlay 套检底片
 Insulation Resistance 绝缘电阻
 Integrated Circuit(IC) 集成电路
 Interconnection 互连
 Interface 界面
 Intermetallic Compound (IMC) 介面合金共化物
 Internal stress 内应力
 Interstitial Via-Hole (IVH) 局部层间导通孔
 Invar 殷钢
 Ion Exchange Resins 离子交换树脂
 Ionic Cleanliness 离子清洁度
 Ionizable (Ionic) Contamination 离子性污染
 Ionization 游离, 电离
 Ionization Voltage (Corona Level) 电离化电压 (电晕水准)
 IPC(The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits) `美国印刷电路板协会
 ~J~
 J-leadJ 型接脚
 JEDEC(Joint Electronic Device Engineering Council 联合电子元件工程委员会
 Job Shop 专业工厂, 职业工厂
 Joule 焦耳
 Jumper Wire 跳线
 Just-In-Time(JIT) 适时供应, 及时出现
 ~K~

Kapton 聚亚 胺软材
Karat 克拉, 开
Kerf 切形, 裁截
Kevlar 聚 胺纤维
Key 论槽, 电键
Key Board 键盘, 键盘板
Kiss Pressure 吻压, 低压
Knoop Hardness 努普硬度
Kova 科伐合金
Kraft Paper 牛皮纸
~L~

Laminar Flow 平流
Laminar Structure 片状结构
Laminate Void 板材空洞, 层间空洞
Laminates 基板, 积层板
Laminator 压膜机
Land 空环焊垫, 表面焊垫
Landless Hole 无环通孔
Laser Direct Imaging ,LDI 雷射直接呈像
laser Matching 雷射加工法
Laser Photo generator 雷射曝光机
Laser via hole 激光钻孔
Lay Back 刃脚磨损
Lay Up 叠合
Layer to Layer Spacing 层间距离
Leaching 焊散, 漂出, 溶出
Lead 引脚, 接脚
Lead Foot 引脚(腿)
Lead Frame 脚架
Lead Pitch 引脚间距
Legend 文字标记, 符号
Leveling 整平
Lifted Land 孔环(焊垫)浮起
Ligand 错离子附属体
Light Interator 光能累积器, 光能积分器
Light Emitting Diodes ,LED 光二极管
Light Intensity 光强度
Limiting Current Density 极限电流密度
Liquid Crystal Display ,LCD 液晶显示器

Liquid Dielectric 液态介质
Liquid Photoimable Solder Mask, LPSM 液态感光防焊绿漆
Logic circuit 逻辑电路
Lot size 批量
Luminance 发光强度, 耀度
Lyophilic 亲水性胶体
~M~

Macro-Throwing Power 巨观分布力
Major Defect 严重缺点, 主要缺点
Margin 韧带, 脉筋
Marking 标记
Mask 阻剂
Mass Finishing 大量整面, 大量抛光
Mass Lamination 大型压板(层压)
Mass Transport 质量输送
Master Drawing 主图
Mat 席
Matte side 毛面
Mealing 泡点
Measling 白点
Mechanical stretcher 机械式张网机
Mechanical Warp 机械性缠绕
Mechanism 机理
Membrane Switch 薄膜开关
Meniscograp Test 弧面状沾锡试验
Meniscus 弯月面, 上凹面
Mercury Vapor Lamp 汞 灯
Mesh Count 网目数
Metal Halide Lamp 金属卤素灯
Metallized Fabric 金属化网布
Metallization 金属化
Micro-electronics 微电子
Microetching 微蚀
Microsectioning 微切片法
Microstrip 微条
Microthrowing Power 微分布力
Migration Rate 迁移率
Mil 英丝
Minimum Annular Ring 孔环下陷
Minimum Electrical Spacing 电性间距
下限 最窄性间距
Misregistration 对不准, 对不准度

Mixed Component Mounting Technology 混合零件之组装技巧

Modem 调变解调器, 数据机

Modification 修改, 改质

Module 模组

Modulus of Elasticity 弹性系数

Moisture and Insulation Resistance Test 湿气与绝缘电阻试验

Monofilament 单丝

Mother Board 主构板, 母板

Mounting Hole 安装板

Multi-Chip-Module(MCM)多晶片(芯片)模组

Multifwiring Board(or Discrete Wiring Board)复线板

~N~

Nail Head 钉头

N.C. 数值控制

Near IR 近红外线

Negative 负片, 钻尖第一面外缘变窄

Negative-Acting Resist 负性作用之阻剂, 负型阻剂

Negative etch-back 反回蚀

Negative stencil 负性感光膜

Network 网状元件

Newton(N) 牛顿

Newtonian Liquid 牛顿流体

Nick 缺口

Noble Metal Paste 贵金属印膏

Node 节点

Nodule 瘤

Nomenclature 标示文字之符号

Nominal Cured Thickness 标示厚度

Non-Circular Land 非圆形孔环焊垫

Nonconformity 不合格

Non-flammable 非燃性

Non-wetting 不沾锡, 不润湿

Normal Distribution 常态分配, 常态分布

Novolac 酯醛树脂

Nucleation, Nucleating 核化

Numerical Control 数值控制, 数控

Nylon 耐龙

~O~

Occlusion 吸藏

Off-Contact 架空

Offset 第一面大小不均, 钻面不匀

OFHC 无氧高导电铜

Ohm 欧姆

OLB(Outer Lead Bond)外引脚结合

Oligomer 寡聚物

Omega Meter 离子污染检测仪

Omega Wave 振荡波

Opaque 不透明剂, 遮光剂

Open Circuits 断线

Opening/daylight 开档

Optical Comparater 光学对比器

Optical Density 光密度

Optical Inspection 光学检测

Optical Instrument 光学仪器

Organic Contamination 有机污染

Organic Solderability Preservatives(OSP) 有机保护剂

Osmosis 参透

Outgassing 出气, 吹气

Outgrowth 悬出, 横出, 侧出

Output 产出, 输出

Overflow 溢流

Overhang 总浮空

Overpotential (Overvoltage)过电位, 过电压

Oxidation 氧化

Oxygen Inhibitor 氧抑制现象

Ozone Depletion 臭氧层耗损

Overlap 钻尖点分离

~P~

Packaging 封装, 构装

Pad 焊垫 圆垫

Pad Master 圆垫底片

Palladium 钯

Panel 制程板

Panel Plating 全板镀金

Panel Process 全板电镀法

Paper Phenolic 纸质酚醛树脂(板材)

Parting Agent 脱膜剂

Passive Devices (parts) 无源器件
 Passivation 钝化, 钝化处理
 Paste 膏, 糊
 Pattern 板面图形
 Pattern Plating 线路电镀
 Peak Voltage 峰值电压
 Peel Strength 抗撕强度
 Peeling 起皮
 Peripheral 周边附属设备
 Permeability 透气性, 导磁性
 Permittivity 诱电率, 透电率
 Photo via Hole 光致穿孔
 Photofugitive 感光腿色
 Photographic Film 感光成像之底片
 Photoinitiator 感光起始剂
 Photomask 光罩
 Photoplotter, Plotter 光学绘图机
 Photoresist Chemical Machinning
 (Milling) 光阻式化学
 Phototool 底片
 Pick and Place 拾取与放置
 Piezoelectric 压电性
 Pin Grid Array(PGA) 矩阵式针脚封装
 Pinhole 针孔
 Pin 接脚, 插梢, 插针
 Pink Ring 粉红圈
 Pits 麻点
 Plain Weave 平织
 Plasma 电浆
 Plasma via Hole 等离子穿孔
 Plasticizer 可塑剂, 增塑剂
 Plated Through Hole, PTH 镀通孔
 Platen 热盘, 热压板
 Plating 镀
 Plotting 标会
 Plug 插脚, 塞柱
 Ply 层, 股
 Pneumatic Stretcher 气动拉伸器
 Point Angle 钻尖角
 Point Source Light 点状光源
 Point 钻尖
 Poise 泊
 Polar Solvent 极性溶剂
 Polarity 电极性
 Polarizing Slot 偏槽
 Polyester Films 聚酯类薄片
 Polyimide(PI) 聚亚胺
 Pore 针孔
 Porosity Test 疏孔度试验
 Positive Acting Resist 正性光阻剂
 Post Cure 后续硬化, 后续
 Pot Life 适用期, 锅中寿命
 Potting 铸封, 模封
 Power Supply 电源供应器
 Preform 预制品
 Preheat 预热
 Prepreg 胶片 树脂片 半固化片
 Press Plate 钢板, 压膜板
 Press-Fit Contact 挤入式接触
 Primary Image 线路成像
 Probe 探针
 Process Camera 制程用照相机
 Production Board 成品板
 Profile 轮廓, 不面图, 升温曲线
 Propagation 传播
 Puddle Effect 水抗效应
 Pull Away 拉离
 Pulse Plating 脉冲电镀法
 Pumice Powder 浮石粉
 Punch 冲切
 Purge, Purging 净空, 净洗
 Purple Plague 紫疫
 Post Separation 后期分离, 事后分离
 ~Q~
 Quad Flat Pack(QFP) 方扁形封装封体
 Qualification Agency 资格认证机构
 Qualification Inspection 资格检验
 Qualification Testing 鉴定试验
 Qualified Products List 合格产品名单
 Qualitative Analysis 定性分析
 Quality Conformance Test Circuitry
 (Coupon)
 品质符合之试验线路
 Quantitative Analysis 淬火, 骤冷
 Quench 快速接头
 Quick Disconnect 快速接头
 Quill 纬纱绕轴

~R~

Rack 挂架
Radial lead 放射性引脚
Radiometer 辐射计, 光度计
Rake Angle 抠脚, 耙脚
Rated Temperature 额定温度, 额定电压
Real Estate 底版面, 基板面
Reclaiming 再生, 再制
Reel to Reel 卷轮式操作
Reference Dimension 参考尺度, 参考尺寸
Reflow soldering 重熔焊接, 熔焊
Refraction 折射
Refractive Index 折射率
Register Mark 对准用标记
Registration 对准度
Reinforcement 辅助物
Relaxation 剔退, 拒收
Relay 继电器
Release Agent, Release sheets 脱膜剂, 离型膜
Reliability 可靠度, 信赖度
Relief Angle 浮角
Resin Content 胶含量 树脂流量
Residue 残留物
Resin Flux 树脂(松香)助焊剂
Resin Recession 树脂下陷
Resin Rich Area 树脂丰富区, 多胶区
Resin Smear 胶糊渣, 胶渣, 树脂沾污
Resin Starved Area 树脂缺乏区, 缺胶区
Resist 阻剂, 阻膜
Resistivity 电阻系数, 电阻率
Resistor 解像, 解像度(分辨力)
Resistor Drift 电阻漂流
Resolution 解像, 解像度, 解析度
Resolving Power 解析力, 解像力(分辨力)
Reverse Current Cleaning 反电流(电解)清洗
Reverse Etchback 返回蚀
Reverse Image 负片影象(阻剂)

Reversion 反转, 还原
Revision 修正版, 改订版
Rework(ing) 重工, 再加工
Rheology 流变学, 流变性质
Ribbon Cable 圆线缆带
Rigid-Flex Printed Board 硬软合板
Ring/Collar 钻套
Ripple 纹波
Rinsing 水洗, 冲洗
Roadmap 线路与零件之布局图
Robber 辅助阴极
Roller Coating 辊轮涂布
Roller Cutter 锯板机
Roller Tinning 滚锡法
Rosin 松香
Rotary Dip Test 摆动沾锡试验
Routing 切外型, 铣切
Runout 偏转, 累积距差
Rupture 迸裂
~S~
Sacrificial Protection 牺牲性保护层
Salt Spray Test 盐雾试验
Sampling Inspection 抽样检验
Sand Blast 喷砂
Saponification 皂化作用
Satin Finish 绸面处理
Scaled Flow Test 比例流量试验
Schematic Diagram 电路概略图
Scratch 刮痕
Screen Printing 绸板印刷
Screenability 绸印能力
Scrubber 磨刷机
Scum 透明残膜
Sealing 封孔
Seeding 下种
Selective Plating 选择性电镀
Self-Extinguishing 自熄性
Selvage 布边
Semi-Additive Process 半家成制程
Semi-Conductor 半导体
Sensitizing 敏化
Separable Component Part 可分离式零件

Sequential Lamination 接续性压合法
Sequestering Agent 螯和剂
Sewing Hole 缝纫孔
Shadowing 阴影, 回蚀死角
Shank 钻尖柄部
Shear Strength 抗剪力强度
Shearing/Cutting 喇叭孔
Shelf Life 储龄
Shield 遮蔽, 屏蔽
Shore Hardness 萧氏硬度
Short 短路
Shoulder Angle 肩斜角
Shunt 分路
Side Wall 侧壁
Siemens 电阻值
Sigma(standard Deviation)标准差
Signal 讯号
Silane 矽烷
Silicone 矽铜
Silk Screen 绸板印刷
Single-In -Line Package(SIP)单边插脚封装体
Sizing 上胶, 上浆
Skin Effect 集肤效应
Skip Printing Skip Plating 漏印, 漏镀
Slashing 浆经
Sleeve Joint 套接
Sliver 边丝, 边条
Slot, Slotting 槽口, 开槽
Sludge 沉淀物
Slump 塌散
Slurry 绸浆, 悬浮浆
Smear 树脂
Snap-off 弹回高度
Socket 插座
Solder 焊锡
Solderability 焊锡性, 可焊性
Solder Ball 焊锡球, 锡球
Solder Bridging 锡桥
Solder Connection 焊接
Solder Bump 焊锡凸块
Solder Cost 焊锡着层
Solder Dam 锡堤
Solder Fillet 填锡
Solder Leveling 喷锡, 热风整平
Solder Mask(S/M)绿漆, 防焊膜
Solder Paste 锡膏
Solder Plug 锡塞, 锡柱
Solder Preform 预焊料
Solder Projection 锡焊突点
Solder Sag 焊锡垂流物
Solder Side 焊锡面
Solder Spatter 溅锡
Solder Spread Test 散锡试验
Solder Webbing 锡网
Solder Wicking 焊锡之灯心效应
Solderability 可焊性
Soldering 软焊, 焊接
Soldering Fluid, Soldering Oil 助焊液, 护焊液
Solid Content 固体含量, 固形份,
Solidus Line 固相线
Spacing 间距
Span 跨距
Spark Over 伞络
Specification(Spec.)规范, 规格
Specimen 样品, 试样
Spectrophotometer 分光光度计检测法
Spindle 钻轴, 主轴
Splay 斜钻孔
Spray Coating 喷着涂装, 喷射涂装
Spur 底片图形边缘突出
Sputtering 溅射
Squeegee 刮刀
Stalagometer 滴管式表面张力刀
Standard 标准
Stand-off Terminals 直立型端子
Starvation 缺胶
Static Eliminator 静电消除器
Stencil 板膜
Step and Repeat 逐次重复暴光
Step Plating 梯阶式镀层
Sep Tablet 阶段式(光密度)暴光表
Stiffener 辅强条, 辅强板
Stop off 阻剂, 防赌膜
Storage Life 储存期
Strand 纹
Stray Current 迷走电流, 散杂电流

Stress Corrosion 应力腐蚀
Stress Relief 消除应力
Strike 预镀, 打底
Stringing 拖尾, 牵丝
Stripper 剥除液, 剥出器
Subtractive Process 减成法
Substrate 底材
Supported Hole (金属) 支助通孔
Surface Energy 表面能
Surface Insulation Resistance(SIR)表面绝缘电阻
Surface Mount Component 表面贴装元件
Surface Mount Technology 表面贴装技术
Surface Tension 表面张力
Surface-Mount Device 表面粘装零件
Surfactant 表面润湿剂
Surge 突流, 突压
Swaged Lead 压扁式引脚
Swelling Agents; Sweller 蓬松剂
Swimming 线路滑离
Synthetic Resin 合成树脂
~T~

Tab 接点, 金手指
Taber Abrader 泰伯磨试器
Tape Automatic Bonding(TAB) 卷带自动结合
Tape Test 撕胶带试验
Tape Up Master 原始手贴片
Taped Components 卷带式连载零件
Taper Pin Gauge 锥状孔规
Tarnish 污化, 金属变色
Teflon 铁氟龙
Telegraphing 浮印, 隐印
Temperature Profile 温度曲线
Template 模板
Tensile Strength 抗拉强度
Tensiometer 张力计
Tenting 盖孔法
Terminal 端子
Terminal Clearance 端子空环, 端子让环

Test Board 测试版
Tetrafunctional Resin 四功能树脂
Thermal Conductivity 导热率
Thermal Cycling 热循环, 热震荡
Thermal Mismatch 感热失谐
Thermal Relief 散热式镂空
Thermal Zone 感热区
Thermocompression Bonding 热压结合
Thermocouple 热电偶
Thermode 发热体
Thermomechanical Analysis(TMA)热机分析法
Thermoplastic 热塑性
Thermosetting 热固化
Thermosonic Bonding 热超音波结合
Thermo-Via 导热孔
Thick Film Circuit 厚膜电路
Thief 辅助阴极,
Thin Copper Foil 薄铜箔
Thin Core 薄基板
Thin Film Technology 包膜技术
Thinner 调薄剂
Thixotropy 抗垂流性, 摇变性, 摇溶性
Three-Layer Carrier 三层式载体
Threshold Limit Value(TLV)极限值
Through Hole Mounting 通孔插装
Through Put 物流量, 物流通过量
Throwing Power 分布力
Tie Bar 分流条
Tin Drift 锡量漂飘失
Tin Immersion 浸镀锡
Tin Pest 锡疫
Tin Whiskers 锡须
Tinning 热沾焊锡
Tolerance 公差
Tombstoning 墓碑效应
Tooling Feature 工具标的物
Torsion Strength 抗扭强度
Touch up 触修, 简修
Trace 线路, 导线
Traceability 追溯性, 可塑性
Tranducer 转能器
Transfer Bump 移用式突块, 转移式突

块
 Transfer Laminated Circuit 转压式线路
 Transfer Soldering 移焊法
 Transistor 电晶体
 Transmission 传轮线
 Transmittance 透光率
 Treatment, Treating 含浸处理
 Treating 枝状镀物, 镀须
 Trim Line 裁切线
 True Position 真位
 Tungsten 钨
 Tungsten Carbide 碳化钨
 Turnkey System 包办式系统
 Turret Solder Terminal 塔立式焊接端子
 Twill Weave 斜织法, 棱织法
 Twist 板翘
 Two Layer Carrier 两层式载体
 ~U~
 UL Symbol“保险业实验所” 标记
 Ultimate Tensile Strength(UTS)极限抗拉强度
 Ultra High Frequency(UHF)特高频率
 Ultra Violet Curing(UV Curing)紫外线硬化
 Ultrasonic Bonding 超音波结合
 Ultrasonic Cleaning 超音波清洗
 Ultrasonic Soldering 超音波焊接
 Undercut Undercutting 侧蚀
 Underplay 底镀层
 Universal Tester # 用型电测机
 Unsupported Hole 非镀通孔
 Urea 尿素
 Urethane 胺基甲酸乙脂
 ~V~
 V-Cut, V 型切槽
 Vacuum Evaporation(or Deposition)真空蒸镀法
 Vacuum Lamination 真空压和
 Van Der Waals Force 凡得瓦力
 Vapor Blasting 蒸汽喷砂
 Vapor Degreasing 蒸汽除油法
 Vapor Phase Soldering 争相焊接
 Varnish 清漆, 凡力水
 Very large-scale Integration(VLSI)极大积体电路器
 Via Hole 导通孔
 Vickers Hardness 维氏硬度
 Viscosity 沾滞, 沾度
 Vision Systems 视觉系统
 Visual Examination(Inspection)目视检查
 Void 破洞, 空洞
 Volatile Content 挥发分含量
 Voltage 电压
 Voltage Breakdown (崩)溃电压
 Voltage Drop 电压降落
 Voltage Efficiency 电压效率
 Voltage Plane 电压层
 Voltage Plane Clearance 电压层的空环
 Volume Resistivity 体积电阻率
 Volumetric Analysis 容量分析法
 Vulcanization 硫化, 交连
 ~W~
 Wafer 晶圆
 Waive 暂准过关, 暂不检验
 Warp ,Warpage 板弯
 Warp Size 浆经处理
 Washer 垫圈
 Water Absorption 吸水性
 Water Break 水膜破散, 水破
 Watermark 水印
 Watt 瓦特
 Watts Bath 瓦磁镀镍液
 Wave Guide 导波管
 Wave Soldering 波峰焊
 Waviness 波纹, 波度
 Wear Resistance 耐磨度, 耐磨性
 Weatherability 耐候性
 Weave Exposure 波纹显露
 Web 蹼部
 Weft Yarn 纬纱
 Welding 熔接
 Wet Blasting 湿喷砂
 Wet Lamination 湿压膜法
 Wet Process 湿式制程

Wetting Agent 润湿剂
Wetting Balance 沾锡天平
Wetting 沾锡, 沾湿
Whirl Brush 旋涡式磨刷法
Whirl Coating 旋涡涂布法
Whisker 晶须
White Residue 白色残渣
White Spot 白点
Wicking 灯芯效应
Window 操作范围, 传动齿孔
Wire Bonding 打线结合
Wire Gauge 线规
Wire Lead 金属线脚
Wire Wrap 绕线互连
Wiring Pattern 布线图形
Working Master 工作母片
Workmanship 手艺, 工艺水准, 制作水准
Woven Cable 扁平编线
Wrought Foil 锻碾金属箔
~X~

X Axis X 轴
x-ray Fluorescence X 射线萤光, X 萤光
x-ray X 光
~Y~

y-axis Y Y 轴
Yarn 纱, 线
Yield 良品率, 良率, 产率
~Z~

z-axis Z 轴
zigzag In-Line Package(ZIP) 链齿状双排脚封装件

增补部分

Abrasives 磨料, 刷材
Acceptable Quality Level(AQL) 允收品质水准
AC Impedance 交流阻抗
Acoustic Microscope 感音成像显微镜
Active Carbon 活性炭
Aerosol 喷雾剂, 气溶胶, 其悬体
Aluminum Nitride(AIN)氮化铝
Amorphous 无定型, 非晶形
Analog Circuit/Analog Signal 类比电路, 类比讯号
Anisotropy 异向的, 单向的
Anti-Foaming Agent 消泡剂
Apertures 开口, 钢板开口
Aramid Fiber 聚胺纤维
Attenuation 讯号衰减
Balanced Transmission Lines 平衡式传

轮线
Ball Grid Array 球脚阵列 (封装)
Bi-Level Stencil 双阶式钢板
Blur Edge(Circle)模糊边带, 模糊边圈
Brown Oxide 棕氧化
Build Up Process 增层法制程
Bumping Process 突块制程
C4 Chip Joint C4 晶片焊接
C-Stage C 阶段
Cation 阴向游子, 阳离子
Chip Interconnection 晶片互连
Chip On Glass 晶波接装 (GOG)
Chlorinated Solvent 含氧溶剂, 氧化溶剂
Condensation Soldering 凝热焊接, 液化放热焊接
Controlled Depth Drilling 定深钻孔
Copper-Invar-Copper(CIC) 综合夹心板
Core Material 内层板材, 核材
Crossover 越交, 搭交
Crosshatch Testing 十字割痕试验
Crystalline Melting Point 晶体熔点
Daisy Chained Design 菊瓣环设计
Debris 碎屑, 残材
Dicing 晶片分割
Die Attach 晶粒安装
Discrete Wiring Board 散线电路板, 复线板
Disturbed Joint 受扰焊点
Doctor Blade 修平刀, 刮平刀
Drift 漂移
Dynamic Flex(FPC) 动态软板
DYCO state 点浆蚀孔增层法
E-Beam(Electron Beam) 电子束
Electroform 电铸
Emulsion Side 药膜面
Encroachment 沾污, 侵犯
Entek 有机护铜处理 (裸铜板)
Exothermic 放热 (曲线)
Fan Out Wiring/Fan in Wiring 扇出布线, 扇入布线
Film Adhesive 接着膜, 粘合膜
Finite Element Method 有限要素分析

法
Fine Pitch 密脚距, 密线距, 密垫距
Flame Point 自燃点
Flatness 平坦度
Flexural Module 弯曲模数, 抗扰性模数
Flip Chip 覆晶, 扣晶
Flush Point 闪火点
Four Point Twisting 四点扭曲法
Freeboard 干弦
Frit 玻璃熔料
Fusing Fluid 助熔剂
Gallium Arsenide(GaAs) 砷化镓
Galvanic Corrosion 贾凡尼氏腐蚀
Gate Array 闸极阵列, 闸列
Glaze 釉面, 釉料
Glob Top 圆顶封装体
Glycol(Ethylene Glycol) 乙二醇
Halation 环晕
Heat Dissipation 散热
Heat Distortion Point (Temp.) 热变形点(温度)
Heat Transfer Paste 导热膏, 传热膏
High Efficiency Particulate Air Filter(HEPA)高效空气尘粒过滤器
Impregnate 含浸
Interpose 互连导电物
Ion Migration 离子迁移
Junction 接合面, 接头
Kauri-Butanol Value 考立丁醇值(K.B值)
Known Good Die(KGD) 已知之良好晶片
Lamda Wave 延伸平波
Laser Soldering 雷射焊接法
Lead Pitch 脚距
Leakage Current 漏电电流
Local Area Network 区域性网络
Logic 逻辑
Loss Tangent (Tan &DK) 损失正切
Major Weave Direction 主要织向
Mean Time To Failure(MTTF) 故障前可用之平均时数
Micelle 微胞
Microstrip Line 微条线, 微带线
Microwave 微波
Micro Wire Noard 微封装(漆包线)板
Minor Weave Direction 次要织向
Mole 摩尔, 克分子, 克原子
Mold Release 脱模机, 离型剂
Molded Circuit 模造立体电路板
Mounting Hole 组装孔, 机装孔
Normal Concentration(Strength) 标准浓度, 当量浓度
N-Methyl Pyrrolidine(NMP) N-甲基四氢吡咯
Oilcanning 盖板弹动
On-Contact Printing 密贴式印刷
Organic Solderability Preservatives(OSP) 有机保焊剂
Pads Only Board 唯垫板
pH Value 酸#值
Phase 相
Phase Diagram 相图
Pits 凹点
Pitch 跨距, 脚距, 垫距, 线距
Plowing 犁沟
Pogo Pin 伸缩探针
Polymerization 聚合
Polymer Thick Film(P 厚膜糊
Popcorn Effect 爆米花效应
Pressure Foot 压力脚
Print Through 压透, 过度挤压
Process Window 操作范围
Production Master 生产底片
Propagation Delay 传播延迟
Pyrolysis 热裂解, 高温分解
Rasio Frequency Interference(RFI) 射频干扰
Read Time System 即时系统
Reflection 反射
Relamination(Re-lam) 多层板压合
Resin Coated Copper Foil 背胶铜箔
Resistor Paste 电阻印膏
Reverse Osmosis(RO) 反渗透
Ring 套环
Rise Time 上升时间
Roller Coating 滚动涂布法

Saponifier 包化剂	Zero Centering 中心不变 (叠合法)
Scoring ,V V 型刻槽	电路板常用简字总整理
Separator Plate 隔板, 钢板, 镜板	
Silver Paste 银膏	Ampere
Silica Gel 矽胶砂	安培
Sintering 烧结	Angstrom
Sizing 上浆处理	埃
Silver Migration 银迁移	ABS(Acrylonitrile Butadiene-Styrene)
Skip Solder 缺锡, 漏锡	丙溪烯氰 丁二烯 苯乙烯
Smudging 锡点沾污	AC(Alternating Current)
Soft Contact 轻触	交流电
Soft Glass 软质玻璃 (铅玻璃)	ACF (Anisotropy Conductive Film)
Solder Column Package 锡柱脚封装法	单向导电膜
Solder Splash 溅锡	ACL (Advanced CMOS Logic)
Solder Webbing 锡网	改进式“互补型金属氧化物半导体”
Specific Heat 比热	逻辑
Spinning Coating 自转涂布	AES (Auger Electron Spectroscopy)
Stagger Grid 蹒跚格点	欧杰电子能谱学
Supper Solder 超级焊锡	ALIVH (Any Layer Inner Via Hole) 任
Surface Resistivity 表面电阻率	意层内部导通孔
Surface Speed 钻针表面 (切线) 速度	ANOVA(Analysis Of Variance)
Tackiness 黏着性, 黏手性	变异数分析
Tape Casting 带状铸材	ANSI (American National Standard
Tarnish 污化, 污着	Institute)
Tetra-Etch 氟树脂蚀粗剂	美国标准协会
Thermal-Via 导热孔, 散热孔	AOI (Automatic Optical Inspection)
Thermogravimetric Analysis (TGA) 热	自动光学检测
重分析法	AOQ (Average Outgoing Quality)
Thermode Soldering 热摸焊接法	平均出货品质
Thermount 聚#胺短织席材	AQL(Acceptable Quality Level)
Thin Small Outline Package(TSOP) 薄	合格允收水准
小型体积电路器	ASIC(Application Specific Integrated
Three Point Bending 三点压弯试验	Circuit)
Topography 表面 地形	特定用途之积体电路器
Translucency 半透性	ASME(American Society for
Trim 修整, 修改数值, 精修	Mechanical Engineers)
Unbalanced Transmission Line 非平衡	美国机械工程师协会
性传轮线	ASTM(American society for Testing and
Vacuoles 焊洞	Material)
Wedge Bond 楔形结合点	美国材料及试验协会
Wedge Void 楔形缺口 (破口)	ATE(Automatic Test Equipment)
Wiping Action 滑动接触 (导电)	自动电测设备
Wrinkle 皱摺, 皱纹	ATM(Atmosphere)
Yield Point 屈服点, 降服点	大气压

AUX(Auxiliary)	电脑辅助工程
辅助设备, 备用品	CAF(Conductive Anodic Filament)
AWG(American Wire Gauge)	阳极性玻织丝之漏电现象
美国线号规	CAM(Computer Aided Manufacturing)
BB Ratio(Book to Bill Ratio)	电脑辅助制造
订单与帐单比例	CAT(Computer Aided Testing(or Teaching))
BCS(Butyl Cellosolve)	电脑辅助测试 (或教学)
丁基溶织素 (俗称防白水)	CC-4(Copper complexer-4)
BDMA(Benzyl dimethylamine)	是美国 PCK 公司所开发在特殊无铜箔基板上的全加成法
苯二甲基胺	CCD(CHARGE Coupled Device)
Be'(Baume')	电荷偶合器
波美度 (英制热量单位)	CCL(Copper Clad Laminate)
BGA(Ball Grid Array)	铜箔基板 (覆铜板)
球栅阵列 (矩阵式球垫表面黏装设备)	CCW(Count Clockwise)
BITE(built-in Test Equipment)	反时针方向
内建式测试设备	C.D.(Current Density)
BOD(Biochemical Oxygen Demand)	电流密度
生化需氧量	C-DIP(Ceramic Dual-in-line Package)
BT Resin(Bismaleimide Triazine Resin)	瓷质双排封装体
双顺丁烯二酸 亚胺/三氮 之复合树脂	CFC(Chloro-Fluoro-Carbon)
BTA (Benzotriazole)	氟氯碳化物
苯基三连唑	CFM(Cubic Feet Per Minute)ft/min
BTAB (Bumped Tape-Automated Bonding)	每一分钟所流过的立方尺数
已有突块的自动结合卷带	CIC(Copper Invar Copper)
BTU (British Thermal Unit)	铜箔层/铁镍合金层/
英制热量单位 (1 Joule=1.055×10 Btu)	CIM(Computer-Integrated Manufacturing)
BUM (Build-up Multilayer) 积层式多层板)	电脑整和制造
c,C(Capacitance, Carbon)	CMC(Critical Micelle Concentration)
电容, 碳	临界胶团浓度
C3(Command, Control and Communicate)	CMOS(Complimentary Metal-Oxide Semiconductor)
命令, 监控及沟通	互补性金属氧化物半导体
C4(Controlled Collapse Chip connection)	CMT (Chip Mount Technology) 芯片安装技术
可掌握高度的裸体晶片反扣熔塌焊接	CNC(Computer Numerical Control)
CAD(Computer Aided Design)	电脑化数值控制
计算机辅助设计	COB (Chip on Board) 载芯片板
CAM (Computer Aided Manufacturing)	CON(Chip On Board)
计算机辅助制造	晶片在电路板上直接组装
C&C(Computer and Communication)	COD(Chemical Oxygen Demand)
电脑与通讯	化学需氧量
CAE(Computer Aided Engineering)	

Cp(Capability of process)
 制程能力指数
 CPCA (China Printed Circuit Association) 中国印制电路行业协会
 CPU(Central Processing Unit)
 中央处理单位
 CRT(Cathode-Ray Tube)
 阴极射线管
 CSP(Chip Scale Package)
 芯片级封装
 CT-2(Cordless Telephone-Second Generation)
 第二代无线电话
 CTE(Co-efficiency of Thermal Expansion)
 膨胀系数
 CTI(Comparative Tracking Index)
 比较性漏电指数
 db(Decibel)
 分贝 (音量的单位)
 DC(Direct Current)
 直流电
 DESC(Defense Electronic Supply Center)
 美国国防部电子产品供应中心
 DFM(Design For Manufacturing)
 制造导向之设计
 DI (Direct Imaging) 直接成像法
 DICY(Dicyandiamide)
 双氰胺
 DIN(Deutsches Institute for Norman)
 德国标准协会
 DIW (Deionized Water) 去离子水
 DOD(Department of Defense)
 美国国防部
 DOE(Design of Experiment)
 实验计划法
 DOS(Disk Operating System)
 磁碟作业系统
 DRAM(Dynamic random-access Memory)
 动态随机存取记忆器
 SDB (Double-sided Board) 双面印制板
 DP (Delivered Panel) 发货拼板
 DSC(Differential Scanning Calorimetry)
 微差扫描卡记分析法
 DTL(Diode Transistor Logic)
 二极管电晶体逻辑
 ECL(Emitter-Coupled Logic)
 射极耦合逻辑
 ECM(Electro-Chemical Machining)
 电化加工
 ECN(Engineering Change Notice)
 工程内容变更通知单
 ECO(Engineering Change Order)
 工程内容变更执行令
 ED(Electro-Deposited Photoresist)
 电阻光阻
 ED Foil(Electro-Deposited Copper Foil)
 电镀铜箔
 EDM(Electro-Discharge Machining)
 放电加工法
 EDTA(Ethylene Diamine Tetracetic Acid)
 乙二胺四醋酸
 EDX(Energy Dispersive x-ray Fluorescent Spectrometer)
 能量分散式 X 萤光光度计
 EHF(Extra High Frequency)
 特高频率之电磁波 (30—300 GHZ)
 EIA(Electronic Industries Association)
 美国电子工业协会
 EIPC(European Institute of Printed Circuit)
 欧洲印刷电路板协会
 EMI(Electromagnetic Interference)
 电磁干扰
 EPA(Environmental Protection Agency)
 美国联邦环保署
 EMF(Electro-Motive Force)
 电动势
 EMS (Electronic Manufacturing Service)
 电子制造服务
 ESD(Electrostatic Discharge)
 静电放电
 FCC(Federal Communication Commission)

美国联邦通信委员会	高性能液态层析法
FCP (Fine Chip Packaging) 倒芯片封装	HTE(High Temperature Elongation) 高温延伸性（铜箔）
FPT (Fine Pitch Technology) 精细间距技术	IACS(International Annealed Copper Standards) 国际退火铜标准
FET(Field-Effect Transistor) 场效应晶体管	IC(Integrated Circuit) 集成电路
FIFO(First-In First-Out) 先进先出，先到先做	IEC(International Electrotechnical Commission) 国际电工委员会
FPC(Flexible Printed Circuits) 软性电路板	IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) 美国电子电机工程师协会
FR-4(Flame Resistant Laminated) 耐燃性积层板材	ILB(Inner Lead Bonding) 内引脚结合
FRP(Fiber Reinforced Plastic) 纤维强化塑胶	IMC(Intermetallic Compound) （金属）介面合金共化物
GaAs(Gallium Arsenide) “Semiconductor” 砷化镓半导体	I/O(Input /Output (Termination) 输入输出之端子（电极）
Gb/GB(Gigabit/Gigabyte) 十亿位元/十亿位元组	IPA(Isopropyl for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits) 异丙醇
GC(Gas Chromatography) 气象层析法	IPC (Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuit (US)) 美国电子电路与封装协会
GMT(Greenwich Mean Time) 格林威治标准时间	IR(Infrared) 红外线
GSM(Global System of Mobile Phone) 环球行动电话系统	ISDN(Integrated Service Digital Network) 整体数位网路
HAL (Hot Air Levelling) 热风整平	ISHM(International Organization for Standardization) 国际混成微电子协会
HASL(Hot Air Solder Leveling) 喷锡（热风整平）	ITI(Information Technology Industry) 资讯工业
HDTV (High Definition Television) 高画质电视	ITO(Indium Tin Oxide) 氧化锡（透明导体）
HEPA(High Efficiency Particulate Air Filter) 高效空气尘粒过滤机	IVH(Interstitial Via Hole) 局部层间导通孔（内部导通孔）
HIC(Hybrid Integrated Circuit) 混合积体电路	JEDEC(Joint Electronic Devices Engineering Council) 美国联合电子设备工程评议会
HIFI(High Fidelity) 高忠实度	JIPC(Japan Institute of Printed Circuit)
HI-FI(High Fidelity) 高度传真	
Hi-Rel (High Reliability) 高可靠度	
HPLC(High Performance Liquid Chromatography)	

日本印刷回路学会	MTTR(Mean Time To Repair)
JIS(Japan Industrial standard)	平均维修时间
日本工业标准	MW(Molecule Weight)
JIT(Just-In-Time)	分子量
适时供应	NASA(National Aviation and Space Administration)
KGB(Known Good Board)	美国航空及太空总署
测试用标准板	NBS(National Bureau of Standards)
KGD(Known Good Die)	美国标准局
确知良好晶片	NC(Numerical Control)
LAN(Local Area Network)	数值控制
区域网路	NDI(Non-Destructive Inspection)
LASER(Light Alpmification by stimulated Emission of Radiation)	非破坏性试验
雷射	NDT(Non-Destructive Testing)
LCC(Leadless Chip Carrier)	非破坏性试验
无脚晶片载体	NEMA(National Electrical Manufacturers Association)
LCCC(Leadless Ceramic Chip Carrier)	美国电机制造协会
瓷质无脚晶片载体	NMR(Nuclear Magnetic Resonance)
LCD(Liquid Crystal Display)	核磁共振分析法
液晶显示器	OA(Organic Acid)
LCL(Lower Control Limit)	有机酸剂
管制下限	ODM(Original Designer and Manufacturer)
LED(Light-Emitting Diode)	原始设计及制造商
发光二极管	ODP(Ozone Depletion Potential)
LGA(Land Grid Array)	臭氧消耗潜值
焊垫格点排列	OEM(Original Equipment Manufacturer)
LSI(Large Scale Integration)	原始设备
大型集体电路	OFHC(Oxygen-Free High-Conductivity Copper)
MCM(Multichip Module)	高导电型无氧铜
多芯片模组	OJT(On the Job Training)
MEK(Methyl-Ethyl Ketone)	在职训练, 在职教育
丁酮	OLB(Outer-Lead Bonding)
MIPS(Million Instructions Per Second)	外引脚结合
每秒百万指令	OSHA(Occupational Safety and Health Administration)
MLC(Multilayer Ceramic)	美国职业安全健康管理局
小型瓷质多层电路板	OSP(Organic Solderability Preservative)
MLB (Multilayer Board)	有机保焊剂
多层板	PC(Personal Computer) or (Process Control)
MOS(Metal Oxide Semiconductor)	
金属氧化物之半导体	
MTBF(Mean Time Between Failures)	
故障间之平均时间	
MTTF(Mean Time To Failure)	
平均可工作之时间	

个人电脑, 微电脑 或者 (过程控制)	QPL(Qualified Products' List)
PCB(Printed Circuit Board)	合格商名单
印刷电路板	QTA(Quick Turn Around)
PCM(Photoresisted	Chemical
Machining)	快速接单交货
光阻式化学加工	RA(Rosin Activated)
PCMCIA(Personal Computer Memory	活化松香型
Card International Association)国际个	RA FOIL(Rolled Annealed Copper Foil)
人电脑记忆卡协会	压延铜箔
PGA(Pin Grid ARRAY)	RADAR(Radio Detection And Ranging)
矩阵式插脚封装元件	雷达
PH(Acidity or Alkalinity of Aqueous	RAM(Random Access Memory)
Solution)	随即存取记忆体
水溶液之酸碱度值	RCC (Resin Coated Copper Foil) 涂树
PHS(Personal Handyphone System)	脂铜箔
日本手提电话系统	R&D(Research and Development)
PI(Ployimide)	研究发展
聚酰亚胺	Ref.(Reference)
PID(Photoimagible Dielectric)	参考
感光介质	RF(Radio Frequency)
PLA(Programable Logic Array)	无线电波, 射频
可程化逻辑阵列	RFI(Radio-Frequency Interference)
PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)	射频干扰
有脚塑胶封装晶片载体	RGB(Red Green Blue)
PPB(Parts Per Billion)	红绿蓝 (光的三原色)
十亿分之几	RH(Relative Humidity)
PR(Periodic Reverse)	相对湿度
周期性反向	RMA(Rosin Mildly Activated)
PSI(Pounds Per Square Inch)	松香活化型
每平方吋中受压的磅数	RMS(Root Mean Square)
PTF(Polymer Thick Film)	均方根
聚合物厚膜电路片	RO(Reverse Osmosis)
PTFE (Polytetrafluorethylene or Teflon)	反渗透法
聚四氟乙烯 (特氟龙)	ROM(Read Only Memory)
PTH(Plated Through Hole)	唯读记忆体
镀通孔	RPM(Revolutions PER Minute)
PVC(Polyvinyl Chloride)	每分钟旋转次数
聚氯乙烯	RSA(Rosin Super Activated)
PWA(Printed Wiring Assemble)	超活化松香型助焊剂
电路板组装体	RTL(Resistor-Transistor Logic)
PWB (Printed Wiring Board) 印制线路	电阻体/电晶体 逻辑
板	RTV(Room Temperature Vulcanizing)
QML(Qualified Manufactures List)	室温硬化
合格制造厂商名单	SA(Synthetic Activated)
	合成活化型 (助焊剂)

SAE(Society of Automotive Engineers) 美国自动车工程师协会	卷带载体封装
SCR(Silicone Controlled Rectifier) 矽控整流器	TCR(Temperature Coefficient of Resistance) 电阻之温度效应
SEM(Scanning Electron Microscope) 扫描式电子显微镜	TDR(Time-Domain Reflectometry) 时域反射器
SHF(Super High Frequency) 超高频率	TEM(Transmission Electron Microscope) 穿越式电子显微镜
SI(International System of Units) 国际单位系统	TFT(Thin Film Transistor) 薄膜式电晶体
SIMM(Single-In Line Memory Module) 单排记忆模组	Tg(Glass Transition Temperature) 玻璃态转换温度
SIP(Single Inline Package) 单排脚封装体	TGA(Thermal gravimetric Analysis) 热重分析法
SIR(Surface Insulation Resistance) 表面绝缘电阻	TIR(Total Indicated Runout) 所显示之总偏转
SLC(Surface Laminar Circuits) 表面薄层线路	TLV(Threshold Limit Value) 极限值
SMD(Surface Mount Device) 表面黏装元件	TMA(Thermal Mechanical Analysis) 热机分析法
SMOBC(Solder Mask Over Bare Copper) 绿漆直接印与裸板上	TN(Twist Nematic) 扭曲向列型
SMT(Surface Mount Technology) 表面安装技术	TQL(Total Quality Control) 全面品管
SOIC(Small Outline Integrated Circuit) 小型外贴脚积体电路板	TSOP(Thin Small Outline Package) 薄超型外引脚封装体
SOJ(Small Outline J-lead Package) 双排 J 型脚之封装元件	TTL(Transistor Transistor logic) 电晶体电晶体逻辑
SOT(Small-Outline Transistors) 小型外贴脚之电晶体	UCL(Upper Control Limit) 管制上限
SPC(Statistical Process Control) 统计制程控制	UF(Ultrafiltration) 超过滤法
Sp Gr.(Statistical Process Control) 比重	UHF(Ultra-High Frequency) 特高频率之电磁波
SQC(Static Quality Control) 统计品质管制	UL(Underwriters' Laboratories) 美国保险业实验所
SRMA(Static random-access Memory) 静态随机存取记忆器	ULSI(Ultra Large Scale Integration) 超大型机体电路
STN(Super Twist Nematic) 超扭曲向列型	UPS(Uninterruptable Power Supplies) 不间断式电源供应器
TAB(Tape Automatic Bonding) 卷带自动结合技术	UTC(Ultra Thin Copper Foil) 超薄铜皮
TCP(Tape Carrier Package)	UTS(Ultra Tensile Strength)

极限抗拉强度
UV(Ultraviolet)
紫外线
VCR(Video Cassette Recorder)
卡式录影机
VHF(VERY High Frequency)
极高频电磁波
VHSIC(Very Large Scale Integrated
Chips)
极高速机体电路晶片
VLSI(Very Large Scale Integration)
极大型机体电路
VOC(Volatile Organic Compound)
挥发性有机化合物
VPS(Vapor Phase Soldering)
气相焊接
WIP(Work In Process)
制程中的半成品
XPS(x-ray Photoelectron Spectroscopy)
X 射线光电电子能谱术
XRF(x-ray Fluorescence (Spectroscopy))
X 射线荧光谱术, X 荧光术
YAG Laser(Yttrium-Aluminum-Garnet)
乙铝石榴石雷射
ZIP(Zigzag In-line Package)
链齿装单排脚封装体

摘自《印制板资讯》

供稿人：曾莹 最后更新日期：
99-09-03